



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L12524

# 检 测 报 告

样品名称： 集成电路

型号规格： MPC565MZP56

器件品牌： NXP

委托单位：

深圳市创芯在线检测服务有限公司

2025 年 11 月 17 日



## 检 测 报 告

公司：

地址：

样品名称：集成电路

型号：MPC565MZP56

器件品牌：NXP

批次代码：N/A

器件封装：BGA

样品数量：101 片

检测数量：100 片

收样日期：2025/11/07

测试日期：2025/11/10/11:00 - 2025/11/12/18:00

报告专用章

检 测 \_\_\_\_\_

审 核 \_\_\_\_\_

批 准 \_\_\_\_\_



## 测试项目及结论

结果分析			结论
根据委托方要求，对所送100只样品进行了电特性测试共1项检验。未检验到标准缺陷。			✓
测试项目	总数量（片）	检测标准	结果
<input checked="" type="checkbox"/> 文件与包装检查	101	N/A	✓
<input type="checkbox"/> 外观检测	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 丙酮测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> X-ray检测	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> XRF检测	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> 电特性测试	100	GJB 128B-2021 4011、4016	✓
<input type="checkbox"/> 编程烧录	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 关键功能测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> SAT检测	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 热化学测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 可焊性测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 回流焊测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 开盖测试	N/A	N/A	N/A

结果状态：    ✓ 可接受    ✗ 不可接受    ● 可疑的    N/A 未测试&不适用



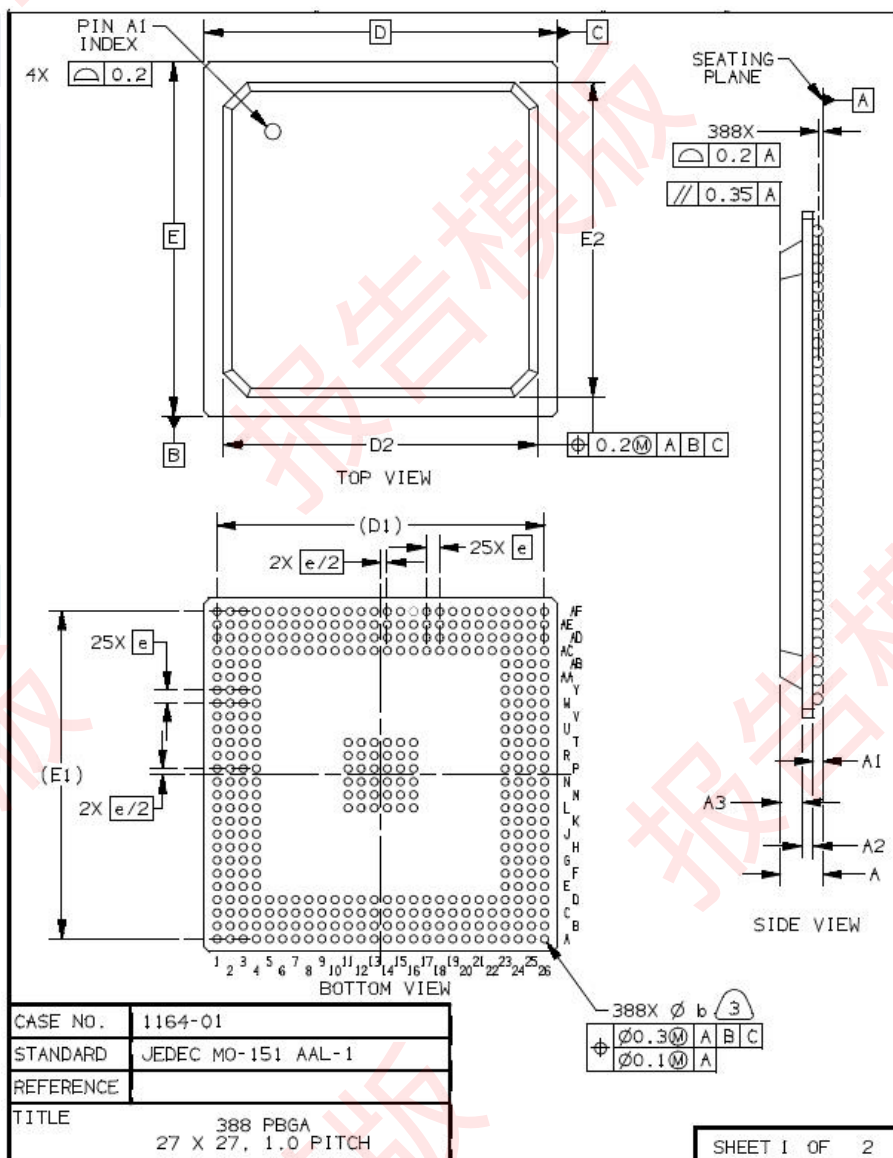
## 测试设备

设备名称	编号	型号	校准有效期至
光学显微镜	TC-S-WG-007	SEZ-260	2026/07/07
半导体管特性图示仪	TC-S-GN-046	CA4810A	2026/07/07
检测依据 《NXP MPC565MZP56》：			
<a href="https://www.nxp.com.cn/docs/en/data-sheet/MPC565RM.pdf">https://www.nxp.com.cn/docs/en/data-sheet/MPC565RM.pdf</a>			

## 1. 芯片描述：

- 带有浮点单元（FPU）和突发缓冲控制器（BBC）的MPC500内核
- 统一系统集成单元（USIU）、灵活的内存控制器和增强型中断控制器
- 1兆字节的闪存（UC3F）
- 36千字节的静态RAM（两个CALRAM模块）
- 三个时间处理器单元（TPU3）

## 2. 封装尺寸：



NOTES

1. DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-1994.
2. DIMENSIONS IN MILLIMETERS.
3. DIMENSION IS MEASURED AT THE MAXIMUM SOLDER BALL DIAMETER, PARALLEL TO PRIMARY DATUM A.
4. PRIMARY DATUM A AND THE SEATING PLANE ARE DEFINED BY THE SPHERICAL CROWNS OF THE SOLDER BALLS.

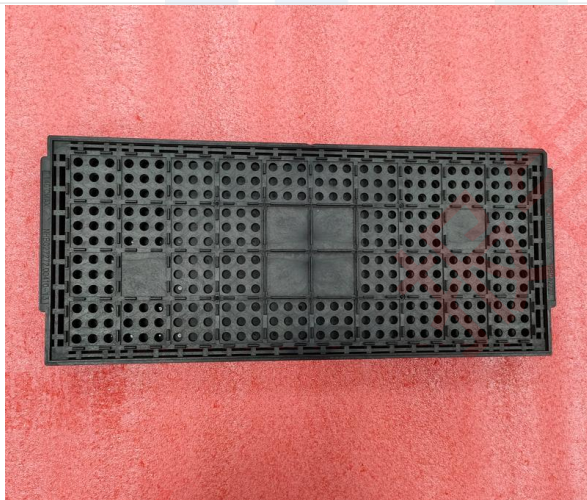
DIM	MILLIMETERS		INCHES		DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX		MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.95	2.55							
A1	0.40	0.60							
A2	0.50	0.70							
A3	1.05	1.25							
b	0.50	0.70							
D	27.00	BSC							
D1	25.00	REF							
D2	23.30	24.70							
E	27.00	BSC							
E1	25.00	REF							
E2	23.30	24.70							
e	1.00	BSC							
CASE NO.		1164-01							
STANDARD		JEDEC MO-15J AAL-1							
REFERENCE									
TITLE		388 PBGA 27 X 27, 1.0 PITCH						SHEET 2 OF 2	



### 3.文件与包装检查：

外箱数量	N/A	外箱尺寸 (cm)	N/A
内箱数量	N/A	内箱尺寸 (cm)	N/A
总重量	702 g	批次代码	N/A
产地	N/A	批号	N/A
来料数量	101片	采样数量	101片
防潮保护	N/A	ESD保护	N/A
样品编号(批次+序号)	#1-#100		

来料图片-1



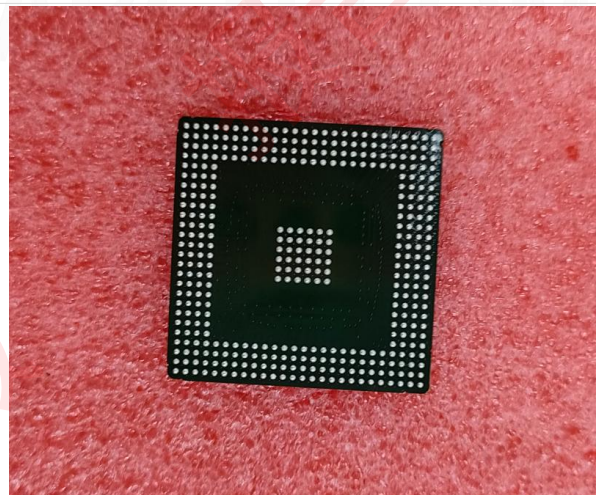
来料图片-2



来料图片-3



来料图片-4



## 4.电特性测试：

依据标准：**GJB 128B-2021 4011、4016**

环境温度：25±3 °C 相对湿度：45%~65% RH

客户提供制造商为**NXP** 型号**MPC565MZP56** 的 101 片用于分析,100 片样品（#1-#100）进行电性能测试。详情如下：

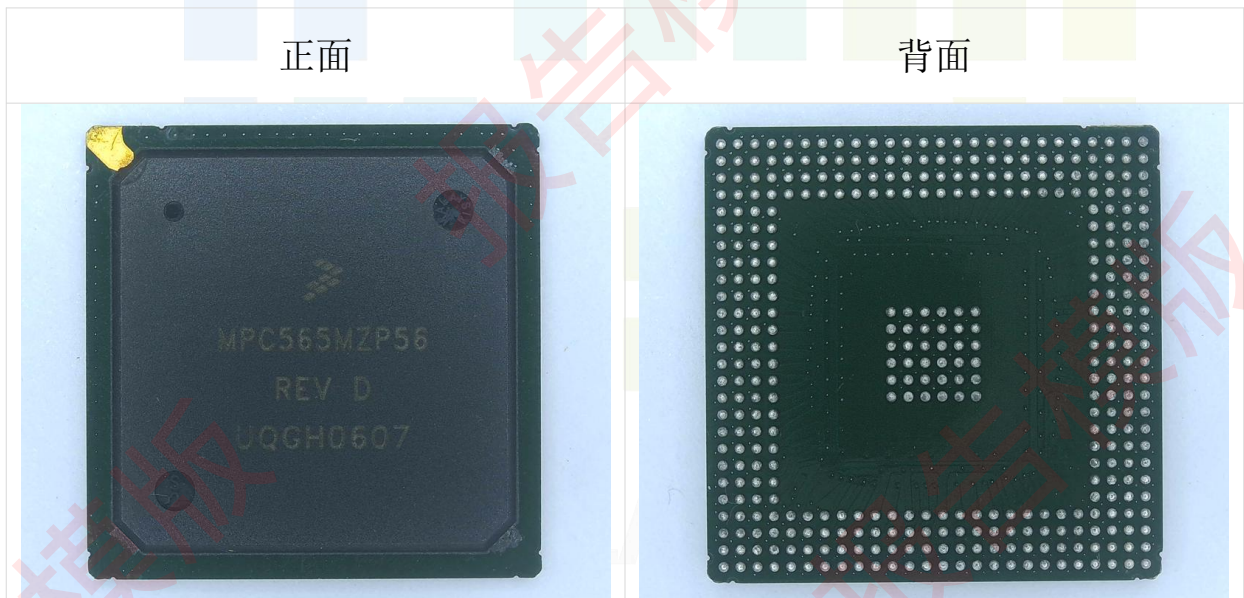
使用半导体管特性图示仪验证芯片管脚电特性曲线，通过开路/短路测试检查芯片是否损坏。

测试条件：

横轴：X=0.5V/div；

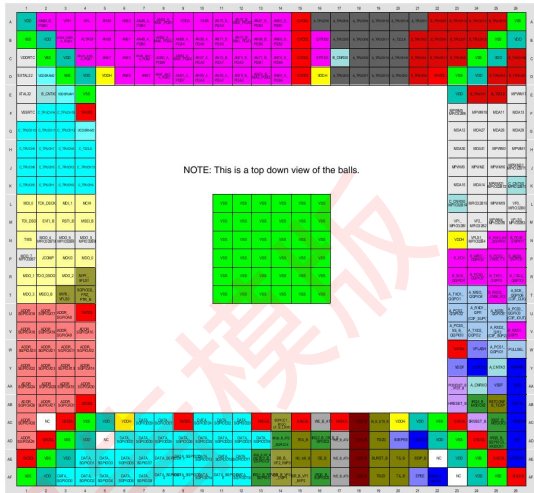
纵轴：Y=0.5mA/div。

100 片样品电特性曲线基本一致，未见明显异常，100 片样品电性能测试通过。

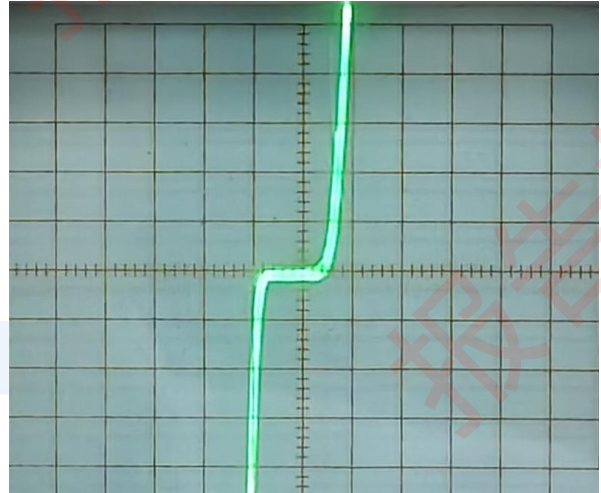




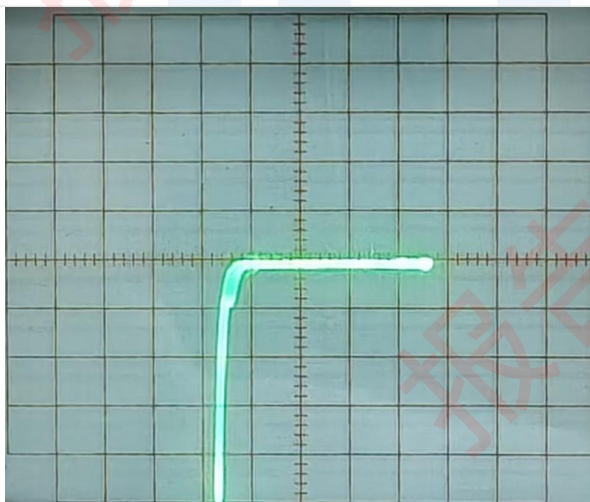
引脚图



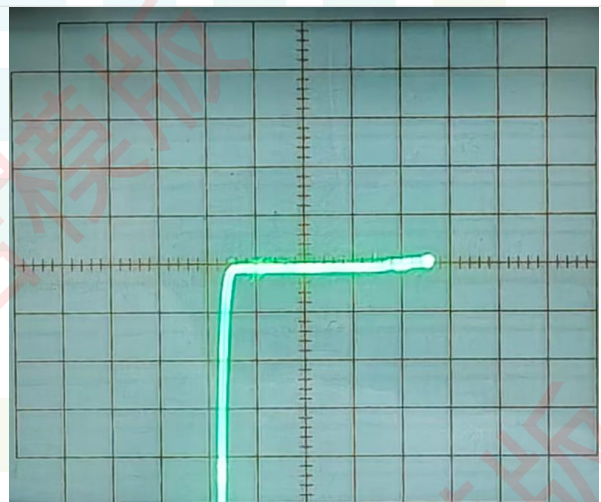
VSS TO PIN A1



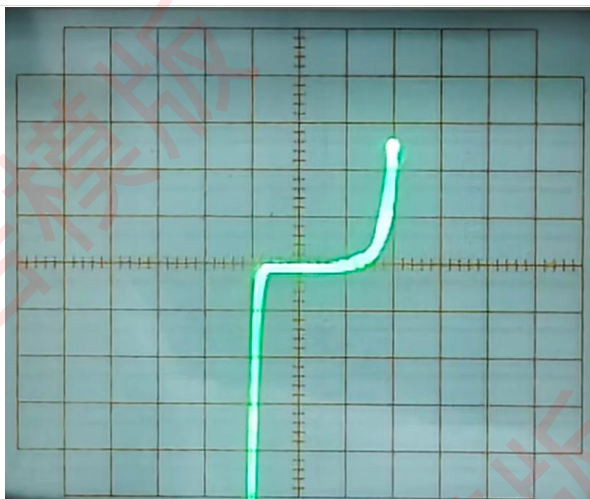
VSS TO PIN A2



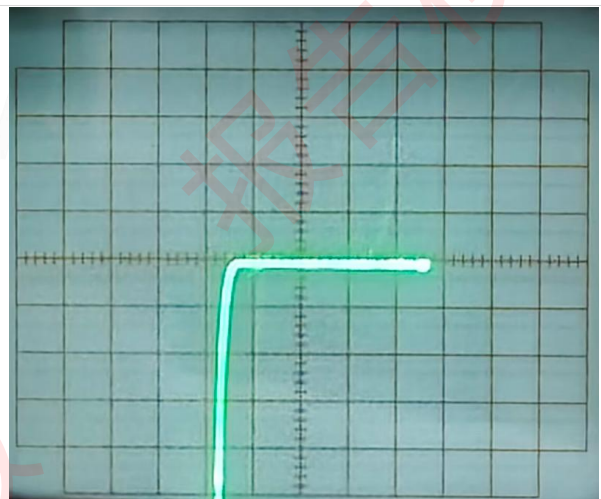
VSS TO PIN A3



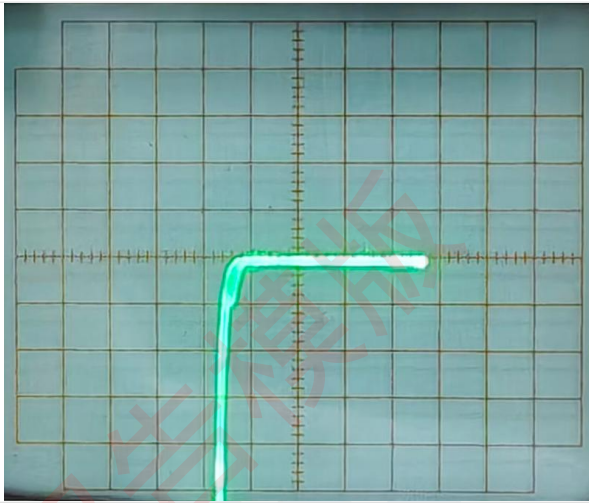
VSS TO PIN F4



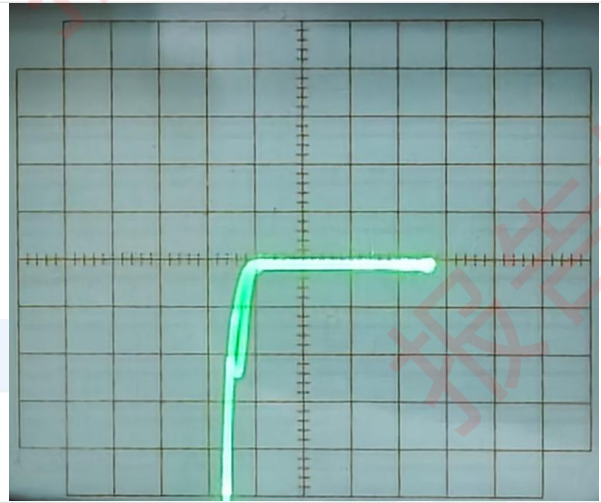
VSS TO PIN G4



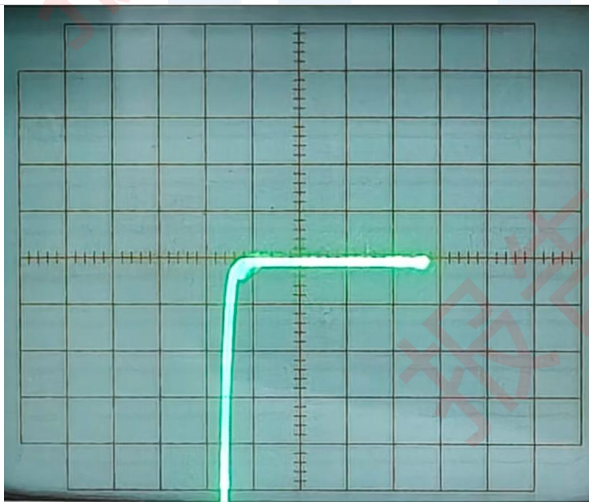
VSS TO PIN H4



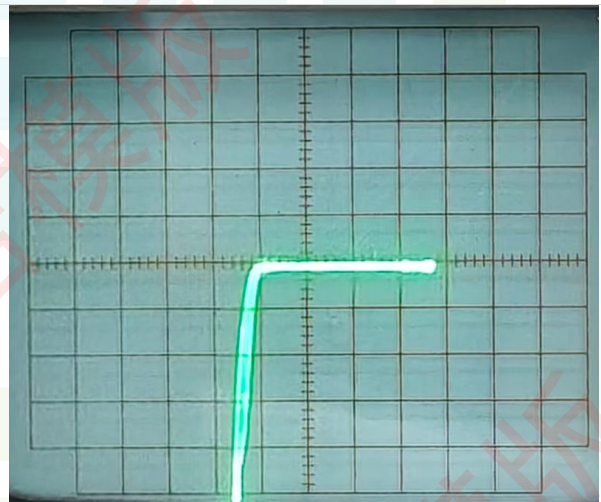
VSS TO PIN AA23



VSS TO PIN AB23



VSS TO PIN AF3



电特性测试	结果:
测试总数	100片
通过数量	100片
失败数量	0片
结论	所有样品的引脚均符合厂商规格说明，通过。



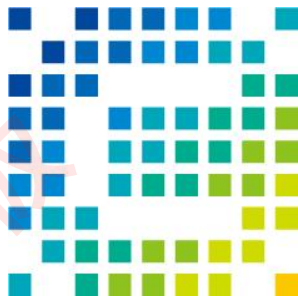
电特性测试结论:		
故障分类	是/否	结论
结构异常	否	可接受
开路测试	否	可接受
短路测试	否	可接受

-报告结束-



## 声 明

1. 检测报告无“公司报告章”及“骑缝章”无效。
2. 复制检测报告未重新加盖“公司报告章”及“骑缝章”无效。
3. 检测报告中无检测、审核、批准人签字视为无效。
4. 检测报告涂改、部分提供和部分复制无效。
5. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 检测报告仅对收样检测结果负责，不对批量产品质量负责。
7. 加\*者为分包检测数据。
8. 报告加盖 CMA 标识，表示检测项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 标识，表示部分/全部检测项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供委托方内部使用。



CXO 实验室公众微信号

电话：0755-83762185

邮箱：engineer@iclabcn.com

网站：<https://www.iclabcn.com>

地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路393号英达丰工业园A栋2楼